2007年3月

La_{2-x-y}Eu_ySr_xCuO₄における超伝導と電荷秩序の競合

Competition between superconductivity and charge ordering in $La_{2xy}Eu_ySr_xCuO_4$

物質系専攻 56138 卞 舜生

指導教員:高木 英典 (教授)

キーワード: La_{2-xy}Eu_ySr_xCuO₄、電荷ストライプ、超伝導電子対密度、Uemuraの関係

<u>背景</u>

高温超伝導体は電子間のクーロン斥力が強く影響する典型的な強相関電子系であり、そのメカ ニズムの解明のためには、超伝導が発現する CuO₂ 面における電子状態を詳細に分析することが 重要である。その特異な電子状態の一つに、いくつかの高温超伝導体の CuO₂ 面において発現す る電荷ストライプがある。これは電荷とスピンが周期的に並ぶ一次元的な電荷秩序である。電荷 ストライプがクーパー対の形成を促す電子間引力を発生し得るとする理論がある一方で、特に低 温で安定している静的電荷ストライプは T_eを抑制することが実験によって観測されている。この ように電荷ストライプは高温超伝導メカニズムの解明に重要なヒントを与えるが、T_e以外の物理 的パラメータにどのような影響を与えるかほとんど分かっていない。

高温超伝導体における最も重要なパラメータの一つに、超伝導電子対密度(*n_s*)がある。高温超 伝導体においては *T_c*が超伝導電子対密度に比例するという Uemura の関係が知られている[1]。 この実験事実から *T_c*を抑制する電荷ストライプの安定化は超伝導電子対密度も減少させることが 類推できる。しかし、電荷ストライプと超伝導電子対密度の関係を明らかにする直接的な実験は 行われていなかった。

本研究の目的と方針

本研究は電荷ストライプの安定化が超伝導電子対密度に対してどのような影響を及ぼすか評価し、CuO2面の電子状態に関する知見を得ることを目的とする。

今回我々は、(La,Sr)₂CuO₄に Eu をドープした La_{2xy}Eu_ySr_xCuO₄の単結晶を用いた。この物 質は Eu ドープによってキャリア濃度(Sr ドープ量)を変えずに電荷ストライプの安定性を制御で きる。さらに、(La,Sr)₂CuO₄と比べて広いキャリアドープ領域で電荷ストライプが安定化してい るので、キャリア量を広い範囲で変えることができる。また、静的ストライプをもつ典型的な物 質である Nd ドープ(La,Sr)₂CuO₄と比べて磁化の分析が簡便であるという利点もある。

本実験では、まず Eu および Sr のドープ量を系統的に変えることによって電荷ストライプの安定性を制御したいくつかの La_{2xy}Eu_ySr_xCuO₄ の単結晶を合成して物性評価した。そして、混合状態の可逆磁化の測定[2]から CuO₂ 面内の磁場侵入長(λ_{ab})を求めた後、電荷ストライプの安定化に伴う超伝導電子対密度の変化を評価した。

単結晶の合成および評価

TSFZ 法によって La_{1.84}·*y*Eu*y*Sr_{0.16}CuO₄(y = 0, 0.1, 0.2)および La_{1.59}Eu_{0.2}Sr_{0.21}CuO₄の単結晶 を合成し、ラウエ法によって結晶軸を決定した後に切り出した。成形したサンプルの電気抵抗率 を四端子法によって測定し、さらにホール係数の測定も行った。



図 1. La_{2-xy}Eu_ySr_xCuO₄の c 軸方向電気抵抗率

図 2. La1.64Eu0.2Sr0.16CuO4のホール係数

図 1 に示すように、*c* 軸方向の電気抵抗率から T_c と、二つの構造相転移温度を求めた。 La_{1.84}, yEu_ySr_{0.16}CuO₄の、高温正方晶(HTT)から低温斜方晶(LTO)への転移は 150~350 K、LTO から低温正方晶(LTT)への転移は 100~150K の範囲で起きていた。また、y = 0.2 と同じ量だけ Eu をドープした La_{1.59}Eu_{0.2}Sr_{0.21}CuO₄ も同様に 150K 付近で構造相転移を示した。Nd ドープ (La,Sr)₂CuO₄ は LTT 構造において電荷ストライプが安定化することが知られており[3]、Eu ドー プに伴う LTO-LTT 構造相転移温度の上昇と T_c の低下は、Eu ドープによる電荷ストライプの安 定化を間接的に示している。

図2にLa1.64Eu0.2Sr0.16CuO4のホール係数の測定結果 を示した。40 K 以下で著しい減少が観測された。これ は一次元的電荷ストライプの発生に伴い電子の移動が 妨げられてホール電圧が減少するために起こると考え られる[3]。他の組成の単結晶に関しては *T*_c以上で同様 なホール係数の減少は観測されなかったが、Eu や Sr のドープ量の違いによる電荷ストライプの安定性の程 度によるものと考えられる。

La1.84- $_{y}$ Eu $_{y}$ Sro.16CuO4に関して図 1,2 から得られた結 果を図 3 の物性相図に示した。この図は Eu の濃度を系 統的に変化させることによって電荷ストライプを安定 させていくと、 T_{c} が低下していくことを示している。



電荷ストライプの超伝導電子対密度に対する影響の評価

上述のように系統的に電荷ストライプの安定性を制御した単結晶を用いて、超伝導電子対密度 の変化をその関数として表される CuO₂ 面内の磁場侵入長(λ_{ab})の変化から求めた($\lambda_{ab}(T \rightarrow 0)$ $\propto n_{s}$ -^{1/2})。磁場侵入長は混合状態の可逆磁化から求めた。混合状態における磁化の対数磁場依存 性は磁場侵入長の関数として表される($dM/dlnH \propto \lambda_{ab}$ -²)ことが、London モデルにより示されて いる[2]。可逆磁化測定の結果の一部を図 4 に示した。La_{1.74}Eu_{0.1}Sr_{0.16}CuO₄の磁化曲線は *lnH*に 対して線形であり、その傾きは温度に伴い系統的に変化している。他の組成の単結晶に関しても 同様に、磁場侵入長を温度の関数として求めることができた。 それらを温度 0 K に外挿した値($\lambda_{ab}(T \to 0)$)を比べ ることで、電荷ストライプの安定化に伴う n_s の変化が 分かった。図 5 はミューオンスピン緩和率 $\sigma(\sigma \propto n_s)$ を横軸、 T_c を縦軸にとり、Uemura の関係と本実験の結 果を比較したものである。Sr 量 x = 0.16 の三つの組成 の結果を比較すると、常伝導状態におけるキャリア量 (Sr 量)が一定であるにもかかわらず、電荷ストライプの 安定化に伴って、超伝導電子対密度が大幅に減少するこ とが明らかになった。さらに、 n_s の低下に伴い T_c が低 下するが、その傾きは Uemura の関係よりも緩やかで ある。また、Eu 量 y = 0.2 の二つの組成の結果から、 Sr のドープ量に関わらずEuのドープによって超伝導電 子対密度が抑制されていることが分かった。これは電荷 ストライプが広いキャリア(Sr)ドープ領域で安定化して いることを示している。

これらの結果は、超伝導と電荷ストライプは互いに競 合しあい、電荷ストライプの形成が超伝導電子対の形成 を妨げる要因になることを示している。超伝導電子対密 度の大幅な抑制はCuO2面における波数空間上の電子密 度の不均一性、または実空間上の超伝導相と電荷ストラ イプの相分離を示唆すると考えられる。



図 4. 様々な温度での

La1.74Eu0.1Sr0.16CuO4のM-H曲線



図 5. Tcと nsの関係

<u>まとめ</u>

Eu と Sr のドープ量を変えることによって電荷ストライプの安定性を制御した La2xyEuySrxCuO4単結晶を合成し、輸送特性の測定などから相図を作成した。さらに混合状態の 可逆磁化測定によって磁場侵入長*Aab*を評価した結果、電荷ストライプの安定化に伴い*T*cととも に超伝導電子対密度も大幅に抑制するという超伝導と電荷ストライプの競合関係が示された。

<u>参考文献</u>

Y. J. Uemura *et al.*, Phys.Rev.Lett. **62**, 2317 (1989).
V.G. Kogan *et al.*, Phys.Rev.Lett. **70**, 1870 (1993).
T. Noda *et al.*, Science **286**, 265 (1999).

学会発表

[1] 卞舜生、笹川崇男、髙木英典、「高温超伝導体の電荷ストライプと超伝導電子対密度」、日本物理学会 2006 年秋季大会(2006 年 9 月、千葉大学)

[2] S. Pyon, T. Sasagawa, H. Takagi, "The influence of static stripes on superfluid density in La_{1.84-y}Eu_ySr_{0.16}CuO₄", 19th International Symposium on Superconductivity, (Nagoya Japan October 30 – November 1, 2006)